

『QFP検査用ソケット』新発売

株式会社ヨコオ
東京都北区滝野川7-5-11
TEL:03-3916-3111(代表)

■要 旨

当社は、既に市場投入しているBGA検査用ソケットに加え、『QFP（クワッド・フラット・パッケージ）検査用ソケット』を新たに開発、販売を開始しました。

■背 景

ICのパッケージ形態ではここ数年、伝送特性等に優れた「BGA・CSP」タイプの需要が急速に増加してきていますが、その一方、ローコスト生産に適した「QFP」タイプも民生機器用として安定した需要が見込まれています。（QFP= Quad Flat Package）

このQFP検査用ソケット市場の中でも、特にリードピッチ0.5mm以下においては、耐久性に優れたソケットが少なく、以前より高耐久性ソケットの開発を顧客より強く要請されました。今回の開発は、こうした顧客ニーズに対応し進めてきたものです。

■『QFP検査用ソケット』の特長

新開発の『QFP検査用ソケット』の大きな特長は、次の通りです。

- ①プローブ方式を採用することにより、他方式に比べ、耐久性が50万回以上となり、格段と向上
- ②短尺プローブを使用したフローティング構造により、確実にICリードへのコンタクトが可能（最小0.4mmピッチ）
- ③プローブ垂直構造により省スペース化が可能となり、多数個取り検査に最適
- ④DUTボードへ取り付けがネジ止めであり、面倒なハンダ付けが不要
- ⑤プローブ単品での交換が容易であり、ランニングコストを大幅に削減

■今後の計画

「QFP検査用ソケット」は既に数社から受注を受けており、今後は、先に市場投入しているBGA用検査用ソケットと共に半導体メーカー各社への積極的な拡販活動を行う予定です。生産については、国内生産拠点の富岡工場（群馬県富岡市）で行います。

★本件に関するお問い合わせ先

回路検査用コネクタ事業部
TEL:03-3916-3116

以 上